

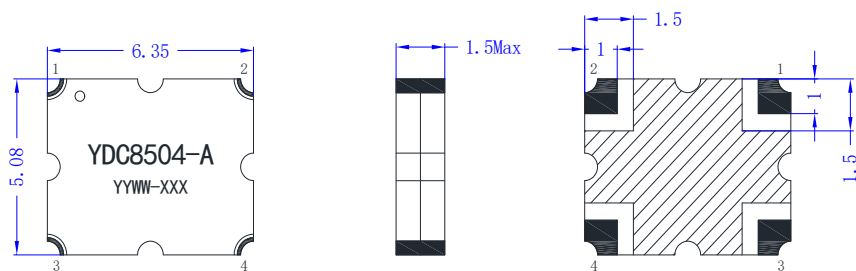
### 特点：

- 通带频率：1200MHz~1700MHz
- 插入损耗：≤0.5dB
- 耦合度：20±1.5dB
- 方向性：≥20dB
- 功率容量：50W
- SMT 封装
- 尺寸：6.35×5.08×1.5(Max)mm

### 性能参数：（50Ω系统， $P_{IN}=0\text{dBm}$ ， $T_A=-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）

| 参数名称   | 符号                 | 测试条件                                  | 参数值       |     |        | 单位  | 备注 |
|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|----|
|        |                    |                                       | MIN       | TYP | MAX    |     |    |
| 通带频率   | $f_c$              | $f=1200\text{MHz}\sim 1700\text{MHz}$ | 1200~1700 |     |        | MHz |    |
| 插入损耗   | IL                 |                                       |           |     | 0.5    | dB  |    |
| 耦合度    | Cou                |                                       | 18.5      | 20  | 21.5   | dB  |    |
| 耦合度平坦度 | $\Delta\text{Cou}$ |                                       |           |     | ±1     | dB  |    |
| 方向性    | Dir                |                                       | 20        |     |        | dB  |    |
| 输入驻波比  | $\text{VSWR}_i$    |                                       |           |     | 1.25:1 |     |    |
| 输出驻波比  | $\text{VSWR}_o$    |                                       |           |     | 1.25:1 |     |    |
| 耦合端驻波比 | $\text{VSWR}_c$    |                                       |           |     | 1.25:1 |     |    |

### 外形尺寸图：



注：1、单位：mm，未标注公差±0.3mm；  
2、产品采用激光刻字标识。

### 引脚定义：

| 接口标识 | 符号                | 接口说明         |
|------|-------------------|--------------|
| 1    | RF IN             | 射频输入端口，DC 耦合 |
| 2    | RF OUT            | 射频输出端口，DC 耦合 |
| 3    | COUPLED           | 耦合输出端口，DC 耦合 |
| 4    | 50Ω TERM EXTERNAL | 外接 50Ω 负载    |

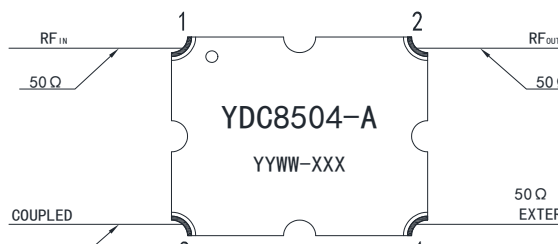
## 字符标志:

| 标识        | 说明   | 备注 |
|-----------|------|----|
| YDC8504-A | 产品型号 |    |
| YYWW      | 批次号  |    |
| XXX       | 序列号  |    |

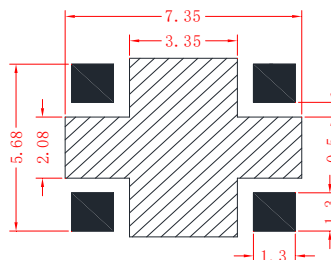
## 极限参数表:

| 参数名称 | 极限值        |
|------|------------|
| 功率容量 | 50W        |
| 装配温度 | +260℃, 20s |
| 工作温度 | -55℃~+85℃  |
| 贮存温度 | -55℃~+100℃ |

## 推荐外围电路:



## 推荐焊盘:

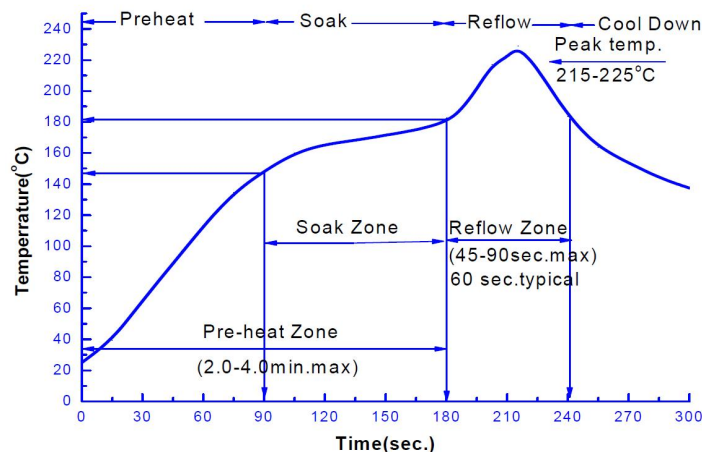


单位: mm

注: 需保证射频端口阻抗为50欧姆。

## 产品使用注意事项:

- 产品在运输、装配使用过程中请注意保护引脚焊盘, 防止引脚焊盘受外界应力影响而出现污损、开裂及脱落等现象;
- 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点 183℃回流焊接, 回流温度推荐曲线:



- 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域), 为了保证连接良好, 底部引脚焊好之后, 需对侧面引脚进行补焊;
- 产品如果需要搪锡, 推荐加热台 170℃助焊, 烙铁 225±5℃辅焊。搪锡建议在 3-5 秒内完成, 去锡需在 5 秒内完成, 不能反复重复搪锡和去锡操作, 且搪锡后器件需自然冷却, 产品搪锡、焊接温度严禁超过 230℃, 超过限定温度。
- 产品拆卸一般采用热台辅助加热, 热风枪局部加热方式。由于热风枪温度难以准确控制, 内部损坏几率较大, 经过拆卸的产品需谨慎使用。
- 产品在运输、装配使用过程中请注意防护, 产品应避免挤压碰撞、谨防高处跌落。
- 产品在存储时需采用防静电袋及干燥剂进行密封包装, 存放条件: 温度-10~+40℃, 相对湿度小于 80%RH; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对宇熙产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。